# <u>Dispositivos de Potencia</u>

66.25 Dispositivos Semiconductores - FIUBA Dr. Ing. Ariel Lutenberg

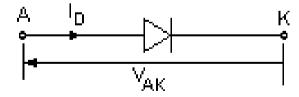
### Organización de la clase

- 1. Introducción a la electrónica de potencia
- 2. Diodos de potencia
- 3. Modelo térmico y cálculo de disipadores
- 4. Tiristores
- 5. Transistores de potencia
- 6. Conclusiones

- Objetivos de la clase:
- Entender las aplicaciones de la electrónica de potencia.
- Conocer diferentes dispositivos de potencia y sus usos.
- Definición de "electrónica de potencia":
- Es la aplicación de dispositivos electrónicos al control y conversión de energía eléctrica.
- Ejemplos: Control de motores, calefacción, sistemas de iluminación, fuentes de alimentación, etc.

- Dispositivos semiconductores de potencia:
  - Se pueden clasificar en cinco tipos:
    - 1. Diodos de potencia
    - 2. Tiristores
    - 3. TBJ de potencia (Transistores bipolares de juntura)
    - 4. MOSFET de potencia
    - **5.IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors)**

#### 1. Diodos de potencia



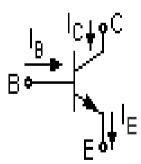
- Sus terminales son ánodo y cátodo.
- Conduce sólo cuando Va > Vk (equivale a un cable).
- Si Vk > Va el diodo no conduce (equivale a un circuito abierto).

#### 2. Tiristores



- Sus terminales son: ánodo, cátodo y compuerta (gate).
- Sólo conduce cuando Va > Vk, y se inyecta una corriente por el Gate (entonces A-K equivale a un cable).
- La única forma de "apagarlo" es forzando Va < Vk .</li>

#### 3. TBJ (Transistor bipolar de juntura)



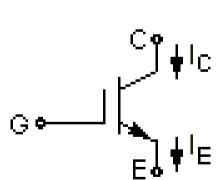
- Sus terminales son emisor, base y colector.
- Sólo conduce cuando VBE > 0.7V
- Si además IB es suficientemente grande, entonces C-E equivale a un cable.

#### 4. MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

- Sus terminales son gate, source y drain.
- Es un dispositivo de conmutación rápida (más rápido que TBJ).
- Sólo conduce si VD > VS y
   VG > VS (n-MOSFET), entonces D-S es "un cable".



- Sus terminales son gate, emisor y colector.
- Combina las mejores características del TBJ y del MOSFET.
- Sólo conduce si VC > VE yVG > VE (nIGBT), entonces C-E "es un cable".

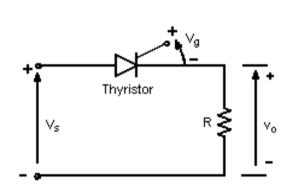


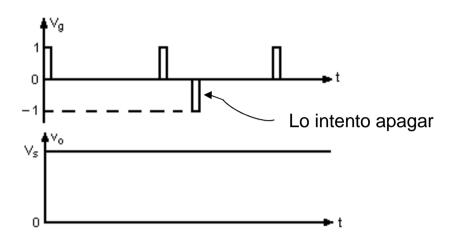
#### Características "típicas" de los dispositivos

Dispositivo		Max. Volt Inverso Max. Corr Directa	Switching time (µs)	Resistencia equivalente
Diodos	Uso general	5000V/5000A	100	0,16m
	High Speed	3000V/1000A	2-5	1m
	Schottky	40V/50A	0,2	10m
Tiristores	Uso general	5000V/5000A	200	0,25m
	High Speed	1200V/1500A	20	0,50m
	Light triggered	6000V/1500A	200-400	0,50m
Transistor	TBJ	400V/250A	10	4m
	MOSFET	500V/9A	0,7	0,6m
	IGBT	1200V/400A	2,3	60m

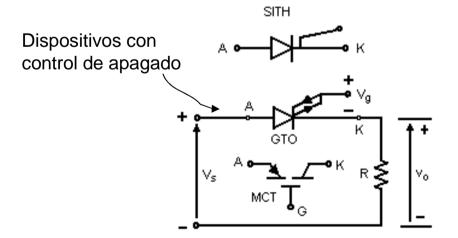
¿Que dato falta en la tabla para poder hacer la comparación?

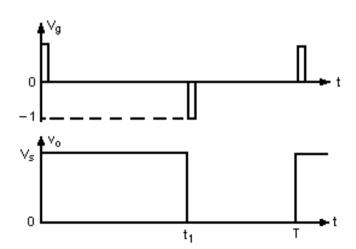
#### Ejemplo de uso de los dispositivos:





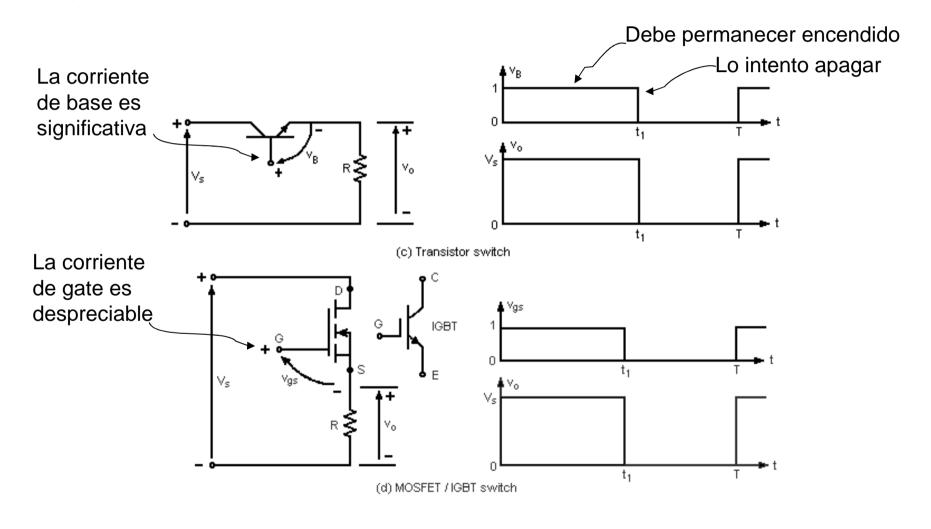
(a) Thyristor switch





(b) GTO/MCT/SITH switch (For MCT, the polarity of  $V_{\rm g}$  is reversed as shown)

#### Ejemplo de uso de los dispositivos:

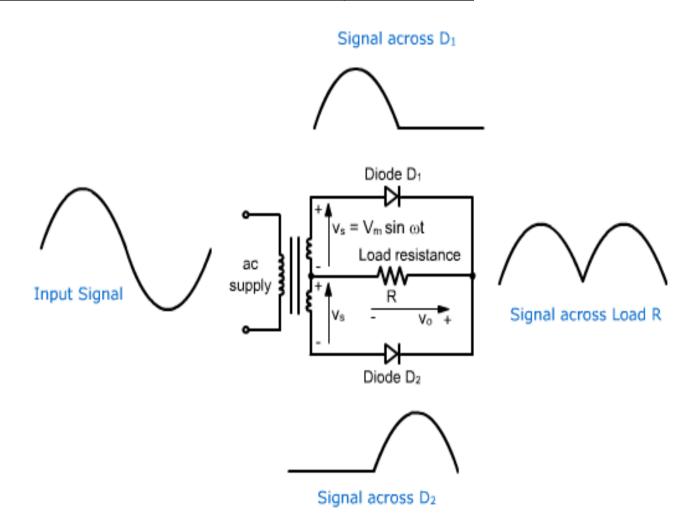


#### Clasificación de los circuitos electrónicos de potencia:

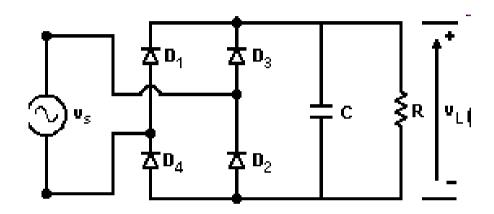
Los dispositivos permiten convertir potencia eléctrica de DC y AC:

- Rectificadores con diodos
- 2. Conversores AC-DC (rectificadores controlados)
- 3. Conversores AC-AC (ac voltage controllers)
- 4. Conversores DC-DC (dc choppers)
- 5. Conversores DC-AC (inverters)

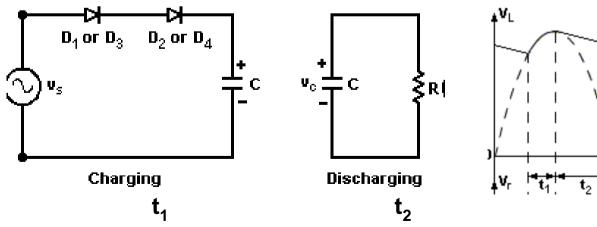
#### 1. Rectificadores con diodos – Ejemplo Nº1:

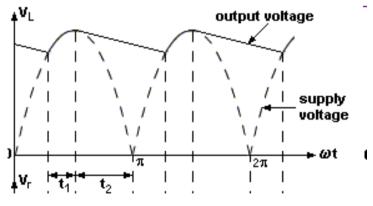


#### 1. Rectificadores con diodos – Ejemplo Nº2:

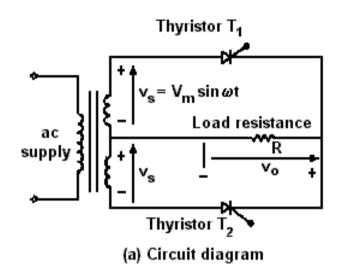


#### **Funcionamiento:**

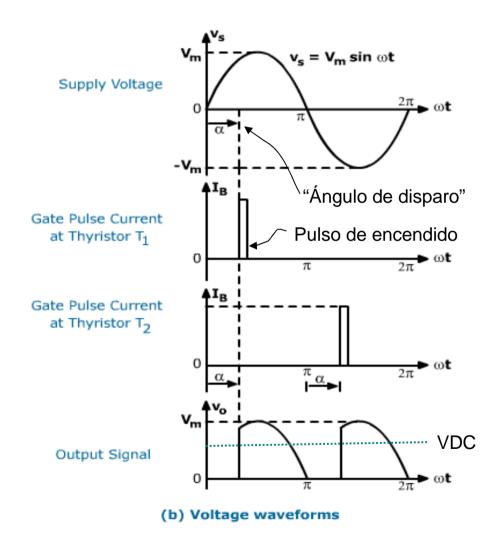




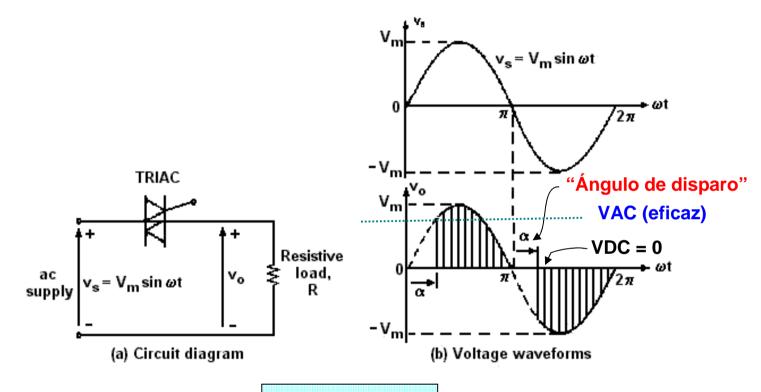
#### 2. Conversores AC-DC - Ejemplo:



Cambiando el ángulo de disparo se modifica VDC

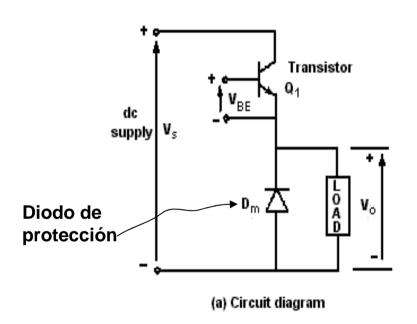


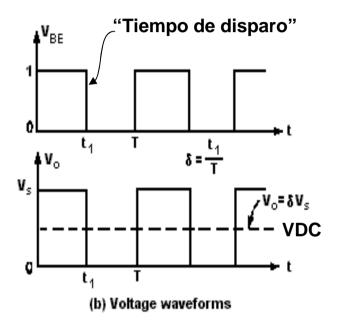
#### 3. Conversores AC-AC - Ejemplo:



Cambiando el ángulo de disparo se modifica VAC

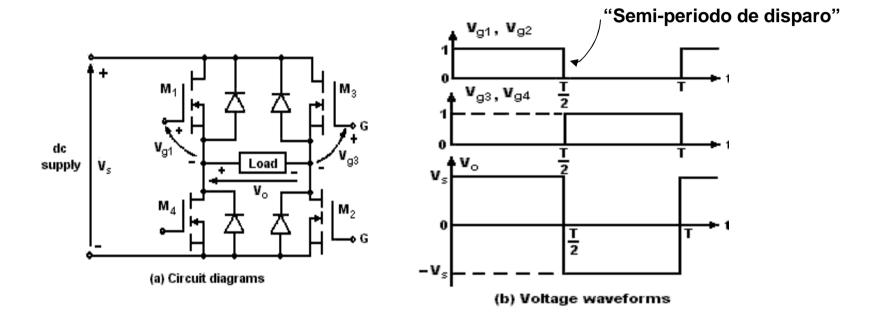
#### 4. Conversores DC-DC - Ejemplo:





Cambiando el duty cycle (t<sub>1</sub>) se modifica VDC

#### 5. Conversores DC-AC - Ejemplo:

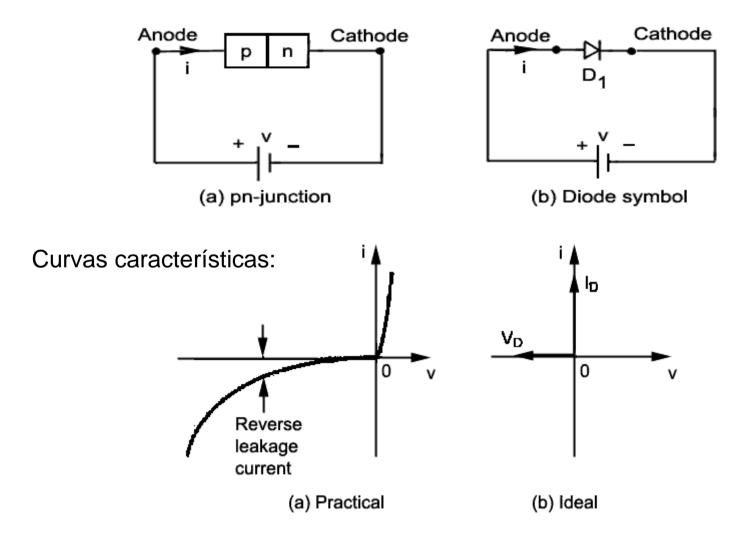


Cambiando el disparo se modifica VAC

#### **Efectos indeseados:**

- Éstos circuitos operan encendiendo y apagándose constantemente, lo que introduce ruido en:
  - La tensión de salida
  - La fuente de alimentación
- Esto genera problemas:
  - Inyecta ruido en la carga
  - Inyecta ruido en la fuente de alimentación
  - Produce interferencia en circuitos cercanos
- Para reducir estos problemas se puede:
  - Usar filtros de entrada y de salida
  - Elegir el circuito más conveniente
  - Usar blindaje electromagnético

#### Esquema del diodo:



Ecuación del diodo:  $I_D = I_s \left( e^{V_D/nV_T} - 1 \right)$ 

#### Donde:

- $I_D$  = corriente que circula por el diodo [A]
- $V_D$  = tensión Va-Vd [V]
- I<sub>s</sub> = corriente de saturación inversa (10<sup>-6</sup> a 10<sup>-15</sup>A)
- n = coeficiente de emisión (1 a 2)
- V<sub>T</sub> = voltaje térmico:

 $q = carga del electrón (1.6022 * 10^{-19} C)$ 

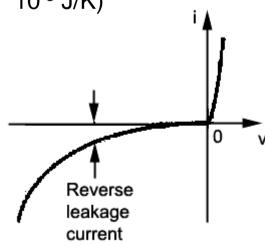
T = temperatura [K]

k = constante de Boltzmann (1.38 \* 10<sup>-3</sup> J/K)

En directa  $(V_D >> V_T)$ :  $I_D \approx I_S (e^{V_D/nV_T})$ En inversa  $(V_D < 0)$ :  $I_D = I_S (e^{V_D/nV_T} - 1) \approx -I_S$ 

$$I_D = I_s (e^{V_D/nV_T} - 1) \approx -I_s$$

En ruptura  $(V_D < V_{BR})$ 



#### Diodos de propósito general:

- Tiempo de recuperación ~ 10 μs
- $1A-6000A / 400V-3600V / V_F = 1.2V$
- Usados en aplicaciones de baja frecuencia (rectificadores de red)

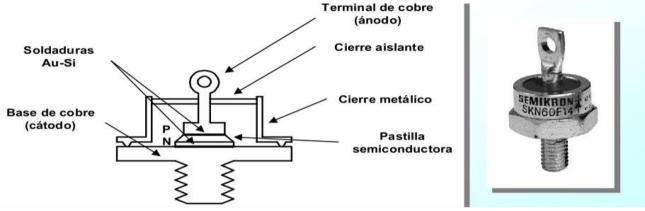
#### **Diodos Fast-recovery**:

- Tiempo de recuperación ~ 0.1 a 10 μs
- $30A-200A / 400V-1500V / V_F = 1.2V$
- Usados como conversores DC-DC o DC-AC (inversores, UPS)

#### Diodos Schottky (metal-semiconductor):

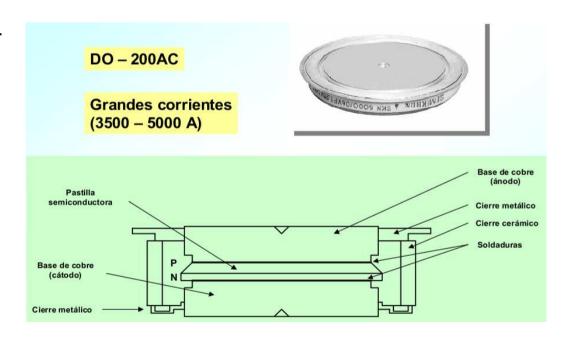
- Tiempo de recuperación ~ 5 ns
- $1A-120A / 15V-150V / V_F = 0.7V$
- Usados en alta frecuencia (fuentes conmutadas, cargadores de baterías)

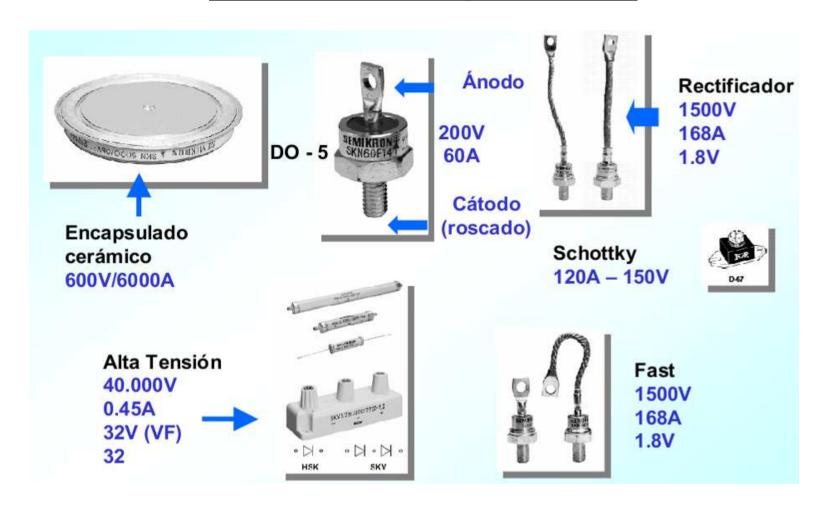
Encapsulado DO-5:



### Función del encapsulado:

- Conexión eléctrica
- Disipación térmica
- Aislamiento eléctrico

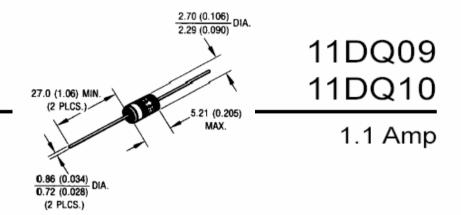




#### Ejemplo de hoja de datos (1/3):

# International Rectifier

SCHOTTKY RECTIFIER



#### Major Ratings and Characteristics

Characteristics	11DQ	Units
I <sub>F(AV)</sub> Rectangular waveform	1.1	Α
V <sub>RRM</sub>	90/100	٧
I <sub>FSM</sub> @ tp = 5 µs sine	85	А
V <sub>F</sub> @ 1 Apk, T <sub>J</sub> = 25°C	0.85	٧
T <sub>J</sub> range	-40 to 150	°C

#### Description/Features

The 11DQ.. axial leaded Schottky rectifier has been optimized for very low forward voltage drop, with moderate leakage. Typical applications are in switching power supplies, converters, free-wheeling diodes, and reverse battery protection.

- · Low profile, axial leaded outline
- High purity, high temperature epoxy encapsulation for enhanced mechanical strength and moisture resistance
- Very low forward voltage drop
- High frequency operation
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability

### Ejemplo de hoja de datos (continuación 2/3):

#### Voltage Ratings

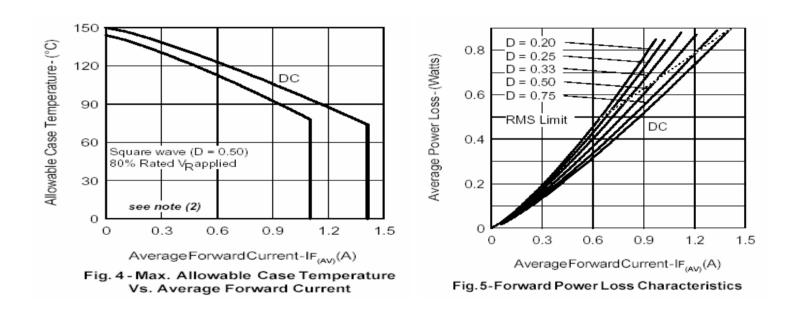
	Part number	11DQ09	11DQ10
$V_R$	Max. DC Reverse Voltage (V)	90	100
V <sub>RWM</sub> Max. Working Peak Reverse Voltage (V)		00	100

#### Absolute Maximum Ratings

Parameters		11DQ	Units	Conditions	
I <sub>F(AV)</sub>	Max.AverageForwardCurrent *SeeFig.4	1.1	А	50%dutycycle@T <sub>c</sub> =75°C,rectangularwaveform	
FSM	Max.PeakOneCycleNon-Repetitive	85	А	5μs Sine or 3μs Rect. pulse	Following any rated load condition and with
	Surge Current *See Fig. 6	14		10ms Sine or 6ms Rect. pulse	rated V <sub>RRM</sub> applied
E <sub>AS</sub>	Non-RepetitiveAvalancheEnergy	3.0	mJ	$T_J = 25 ^{\circ}\text{C}, I_{AS} = 0.5 \text{Amps}, L = 10 \text{mH}$	
I <sub>AR</sub>	RepetitiveAvalancheCurrent	0.2	А	Currentdecaying linearly to zero in 1 $\mu$ sec Frequency limited by $T_J$ max. $V_A = 1.5 \times V_R$ typical	

#### Ejemplo de hoja de datos (continuación 3/3):

Al aumentar la corriente I<sub>D</sub> aumenta la potencia disipada y el diodo comienza a recalentarse:



- Para el silicio debe garantizarse: Tj < Tjmax (por ej. 125°C o 150°C)

### Cálculo de disipadores

Analogía térmico - eléctrica:

Pot.Rt = Tamb  $\rightarrow$  I.R = V



### Regimenes máximos

- Para el silicio debe garantizarse: Tj < Tjmax

Las características térmicas del diodo se definen según:

Estos cuatro casos son exactamente equivalentes (demostrarlo).

### Cálculo de disipadores

Problema: Dado un diodo con máximos: Pdja @ Tamb = 25 °C : 25 W

Pdjc @ Tcase = 25 °C : 70 W

y sabiendo que Pd = 4 W y Ta = 50 °C, determine si debe usarse disipador.

Solución: A partir del modelo térmico:

Del enunciado:

Rjc = 
$$\underline{\text{Tjmax} - \text{Tc}} = \underline{125 \text{ °C}} - \underline{25 \text{ °C}} = 1,4 \text{ °C/W}$$
Pdjc 70 W

Rca =  $\underline{\text{Tjmax} - \text{Ta}} - \text{Rjc} = \underline{125 \text{ °C}} - 25 \text{ °C} - 1,4 \text{ °C/W} = 2,6 \text{ °C/W}$ 
Pdja 25 W

Entonces: Tj = 50 °C + 4W ( 1,4 + 2,6 °C/W) = 66°C < 125°C 

Si no se cumple hay que usar disipador

El disipador quedaría en paralelo con Rca: Rca//Rd  $_{\sim}$  Rd, Rd =  $\underline{Tj}$  –  $\underline{Ta}$  - Rjc

### **Ejercicio**

Un transistor 2N3055 se utiliza en una etapa de salida de potencia en un circuito de audio y disipa una potencia media de 30W. El circuito se encuentra en montado en el interior de un gabinete dónde el aire puede alcanzar una temperatura máxima de 50 °C. El fabricante indica las especificaciones de la figura.

- a) Indicar si en necesario o no colocar un disipador al transistor. Si el disipador es necesario calcular su resistencia térmica.
- b) Si por fallas en la ventilación la temperatura dentro del gabinete aumenta a 75°C, ¿Qué le ocurre al transistor?

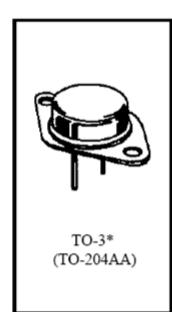
#### MAXIMUM RATINGS

MINIMUTE IN THE PARTY OF			
Ratings	Symbol	Value	Units
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	70	Vdc
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	100	Vdc
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	7.0	Vdc
Base Current	$I_B$	7.0	Adc
Collector Current	$I_C$	15	Adc
Total Power Dissipation @ T <sub>A</sub> = 25°C (1)	D.	6.0	W
$@ T_C = 25^{\circ}C^{(2)}$	$P_T$	117	W
Operating & Storage Temperature Range	Top. Tstg	-65 to +200	°C

#### THERMAL CHARACTERISTICS

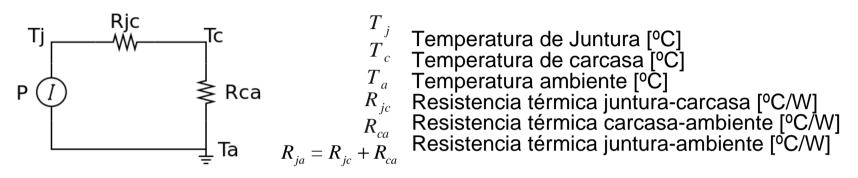
Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	R <sub>OJC</sub>	1.5	°C/W

<sup>1)</sup> Derate linearly @ 34.2 mW/°C for T<sub>A</sub> > +25°C



<sup>2)</sup> Derate linearly @ 668 mW/ $^{\circ}$ C for T<sub>C</sub> > +25 $^{\circ}$ C

#### Ejercicio - Resolución



Datos del fabricante extraídos de los regímenes máximos absolutos:

Temperatura de juntura máxima:  $T_j^{máx} = 200 \, ^{o}C$ 

Disipación de potencia máxima:  $P_{máx} = 6 W @ T_a = 25 ° C$ 

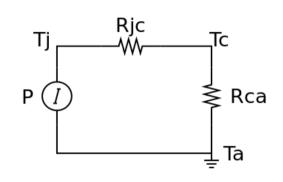
$$P_{m\acute{a}x} = 117W @ T_c = 25 °C$$

Por lo tanto: 
$$R_{jc} = \frac{T_{j}^{m\acute{a}x} - T_{c}}{P_{m\acute{a}x}^{@T_{c}}} = \frac{200 - 25}{177} \frac{^{o}C}{W} = 1.50 \frac{^{o}C}{W}$$

$$R_{ja} = \frac{T_{j}^{m\acute{a}x} - T_{a}}{P_{m\acute{a}x}^{@T_{a}}} = \frac{200 - 25}{6} \frac{^{o}C}{W} = 29.17 \frac{^{o}C}{W}$$

$$R_{ca} = R_{ja} - R_{jc} = (29.17 - 1.50) \frac{^{o}C}{W} = 27.67 \frac{^{o}C}{W}$$

¿Puede el dispositivo, sin disipador externo, disipar 30W a Ta = 50°C?



Verificación: Si 
$$P = 30 W$$
,  $T_a = 50 \, ^oC$  y  $R_{ja} = 29.17 \, \frac{^oC}{W}$ 

Entonces:

Rca 
$$\Rightarrow T_j = R_{ja}P + T_a = 29.17 \times 30^{\circ} C + 50^{\circ} C = 925^{\circ} C$$

Resulta  $T_j^{m\acute{a}x} >> 200^{\circ}\text{C}$  ¿Qué hacemos?

Tipo contenedor	Rjc ('C/W)	Ria ('C/W) sin aleta
TO.5-TO.39	de 10 a 60	de 175a 220
ГО.202	de 12 a 15	de 80a 90
TO, 1 26-SOT,32	de 3 a 15	de 80a 100
ГО.220	de 1,5a 4,2	de 60a 70
O.66 plástico	de 1,5a 4,2	de 60a 70
「O.3 plástico	de 1 a 2	de 35 a 45
O.66	de 4 a 5	de 75a 85
SOT.9	de 4 a 5	de 75a 85
ro.59	de 1,5a 3	de 70a 90
TO.60	de 1,5a 3	de 70a 90
10.3	de 0,8a 3	de 30a 40
ГО.117	de 15 a 35	de 70a 90
SOT.48	de 1,8a 6	de 40a 70







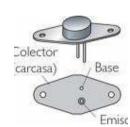
TO-92

TO-5

TO-220



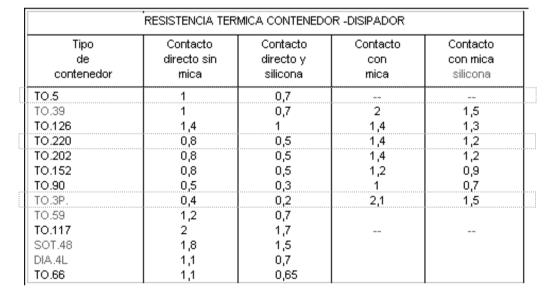


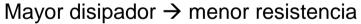


TO-247

TO-218

TO-3









TO-220

**TO-3** 

#### Incidencia de la posición

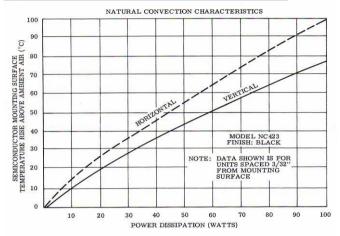


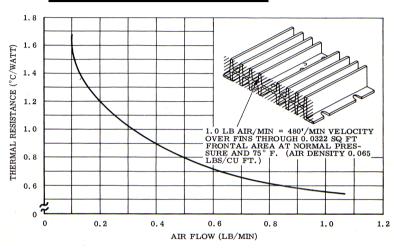
Figure 12-8. Wakefield Engineering — Delta T Model 423

### Diferentes tipos de aislantes

Tabla IV — Comparación de las arandelas aislantes usadas para aislar eléctricamente la cápsula TO-3

Material	Espesor (mm)	θc—s (°C/W)	Capacitancia (pF)
Mica	0,05	0,4	90
Aluminio Anodizado	0,4	0,35	110
Oxido de berilio	1,59	0,25	15

#### Ventilación forzada



#### Mantenimiento de disipadores

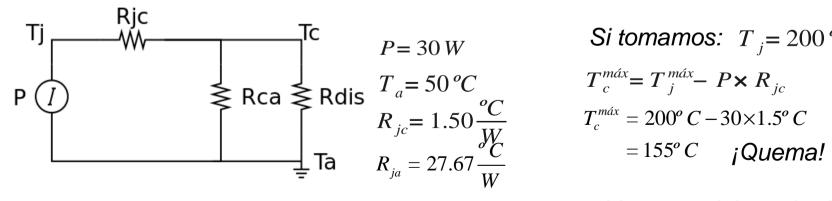
- Limpieza
- Pulido
- Lubricado
- Ajuste

### Ejercicio (resolución - continuación)

Un transistor 2N3055 se utiliza en una etapa de salida de potencia en un circuito de audio y disipa una potencia media de 30W. El circuito se encuentra en montado en el interior de un gabinete dónde el aire puede alcanzar una temperatura máxima de 50 °C. El fabricante indica las especificaciones de la figura.

- a) Indicar si en necesario o no colocar un disipador al transistor. Si el disipador es necesario calcular su resistencia térmica.
- b) Si por fallas en la ventilación la temperatura dentro del gabinete aumenta a 75°C, ¿Qué le ocurre al transistor?

#### Dispositivo con disipador externo:



Si tomamos: 
$$T_j = 200 \, ^{o}C$$

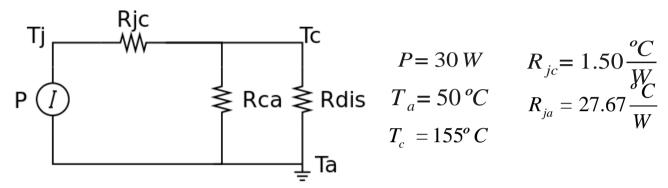
$$T_c^{m\acute{a}x} = T_j^{m\acute{a}x} - P \times R_{jc}$$

$$T_c^{m\acute{a}x} = 200^{o} \, C - 30 \times 1.5^{o} \, C$$

$$= 155^{o} \, C \quad \text{j Quema!}$$

¿Y cuanto debe valer Rdis?

Dispositivo con disipador externo:



Despejando:  $T_c - T_a = P(R_{ca} || R_{dis})$ 

$$R_{ca} || R_{dis} = \frac{T_c - T_a}{P} = \frac{155 - 50}{30} \frac{{}^{o}C}{W} = 3.5 \frac{{}^{o}C}{W}$$
$$\frac{1}{R_{dis}} = \frac{1}{3.5 \frac{{}^{o}C}{W}} - \frac{1}{R_{ca}} \Rightarrow R_{dis} = 4 \frac{{}^{o}C}{W}$$

Verificando:  $T_{j} = T_{a} + P \times (R_{ca} \parallel R_{dis} + R_{jc}) = 50^{o} C + 30W (4 \parallel 27.67 + 1.5) \frac{^{o} C}{W} = 199.8^{o} C$ ¿ Qué ocurre si  $Ta = 75^{o}C$ ?  $T_{j} = T_{a} + P \times R_{total} = 75^{o} C + 30W 5 \frac{^{o} C}{W} = 225^{o} C > 200 °C!!$ 

#### Dispositivo con disipador externo:

Conviene tener un factor de seguridad en la elección del disipador.

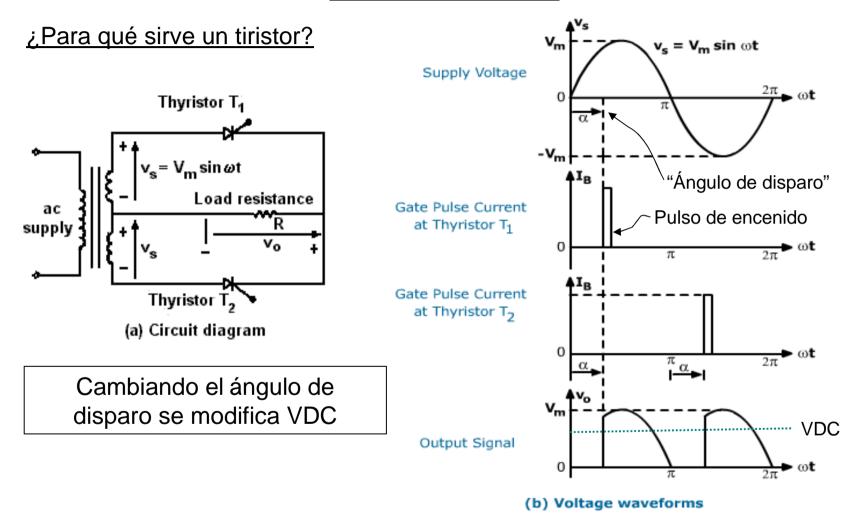
En general se elige un disipador con R 30% menor a la calculada.

Si el cálculo da un disipador de R = 4 °C/W, conviene colocar un disipador de R =  $0.7 \times 4$  °C/W= 2.8 °C/W.

A simple modo de referencia, si queremos utilizar un disipador de aluminio se necesita una superficie de aletas aproximadamente de 156 cm² de acuerdo a la siguiente fórmula empírica:  $R_{dis} = \frac{50}{\sqrt{A}} \frac{cm^o C}{W} \implies A = \left(\frac{50}{4} cm\right)^2 \approx 156 cm^2$ 

Para obtener 2.8 °C/W el disipador tendría una superficie de aletas <u>DOS</u> veces mayor (318 cm<sup>2</sup>).

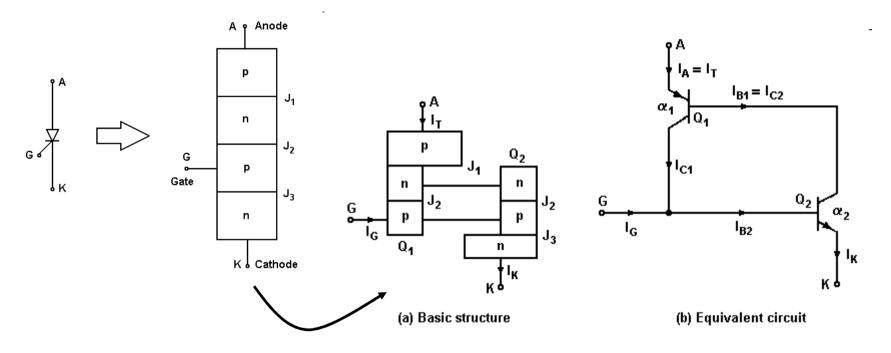
### **4.Tiristores**



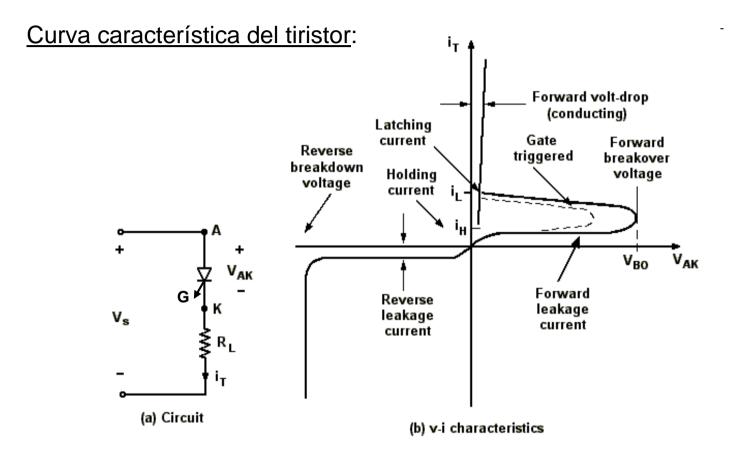
El tiristor es un dispositivo "unipolar" con un terminal de disparo pero sin corte.

# **4.Tiristores**

- El tiristor es uno de los principales dispositivos de potencia.
- Es un sandwich PNPN que puede modelarse como dos transistores:



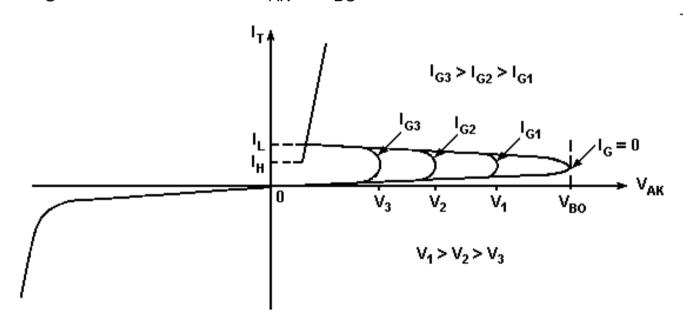
- Si  $I_G = 0$ , entonces es un circuito abierto.
- Si  $I_G = 0$  y  $V_{GK} > V_{BO}$ , el tiristor se dispara, se produce una realimentación positiva (~reacción en cadena) y se transforma en un cable (es peligroso).
- Si  $I_G > 0$  y  $V_{GK} < V_{BO}$ , el tiristor se dispara en forma segura.



VBO (tensión de ruptura): mínima tensión de Vak que dispara al tiristor.  $\mathbf{I}_{L}$ (corriente de latch): es la mínima corriente de encendido del tiristor.  $\mathbf{I}_{H}$  (corriente de retención): mínima corriente que lo mantiene encendido.  $\mathbf{I}_{R}$  (corriente reversa): corriente que circula para Vk > Va.

#### Modos de encendido del tiristor

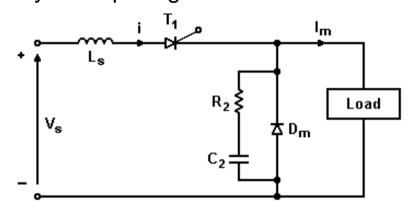
- **Térmico**: La temperatura elevada puede dispararlo por corriente de fuga.
- Luz: Si la luz incide sobre la juntura puede disparar al tiristor.
- Por tensión: Si  $V_{AK} > V_{BO}$  el tiristor se enciende, pero de modo destructivo.
- dv/dt: Si V<sub>AK</sub> varia rapidamente puede disparar al tiristor (no es deseable).
- $I_G$ : Con  $I_G$  > 0 y una tensión  $V_{AK}$  <  $V_{BO}$  el tiristor se enciende.



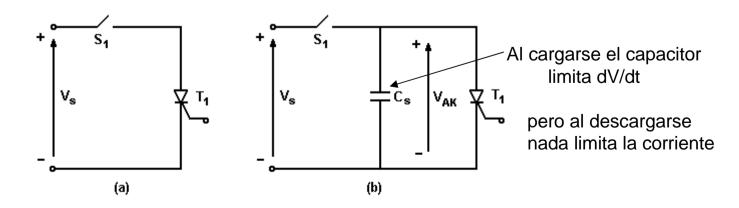
- Luego del encendido I<sub>G</sub> debe ser cero para evitar perdidas en la juntura.
- No debe aplicarse I<sub>G</sub> con el tiristor en inversa, porque podría dispararse.

#### Circuitos de protección

di/dt: si I<sub>T</sub> crece muy rápido no se distribuye uniformemente y se crean hot-spots
El inductor Ls ayuda a proteger al sistema

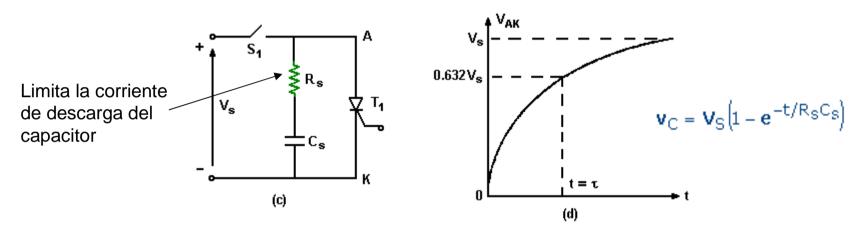


**dV/dt:** si V<sub>AK</sub> crece muy rápido se genera un peligroso sobrepico en I<sub>T</sub>



### Circuitos de protección

**dV/dt:** si V<sub>AK</sub> crece muy rápido se genera un peligroso sobrepico en I<sub>T</sub>



Este circuito es muy habitual y se conoce como "Snubber Circuit"

#### Clasificación de los tiristores:

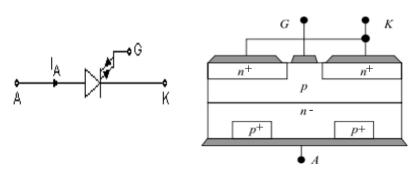
- 1. Silicon control rectifier (SCRs)
- 2. Fast Switching Thyristors (SCRs)
- 3. Gate Turn-off Thyristors (GTOs)
- 4. Triode of Alternating Current (TRIACs)
- 5. Reverse Conducting Thyristors (RCTs)
- 6. Static Induction Thyristors (SITHs)
- 7. Light Activated Silicon
  Controlled Rectifiers
  (LASCRs)
- 8. FET Controlled Thyristors (FET-CTHs)
- 9. MOS Controlled Thyristors (MCTs)

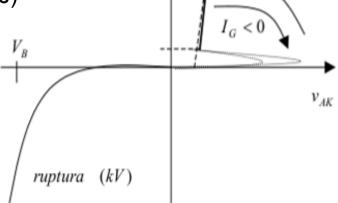
Thyristor (1,2)	A IA O	Gate triggered  O  VAK
SITH (6)  GTO (3)  MCT (9)	A K	Gate triggered  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
TRIAC (4)	A IA B	Gate triggered  Gate triggered  O  Gate triggered
LASCR (7)	A IA G	Gate triggered  O  Gate triggered  AK

Туре		Voltage/current rating	Upper frequency (Hz)	Switching time (µs)
Forced-turned-off	Reverse blocking	5000 V/5000 A	1k	200
thyristors	High speed	1200 V/1500 A	10k	20
	Reverse blocking	2500 V/400 A	5k	40
	Reverse conducting	2500 V/1000 A	5k	40
GATT		1200 V/400 A	20k	8
	Light triggered	6000 V/1500 A	400	200-400
TRIACs		1200 V/300 A	400	200-400
Self-turned-off	GTO	4500 V/3000 A	10k	15
thyristors	SITH	4000 V/2200 A	20k	6.5
MCŤs	Single	600 V/60 A	20k	2.2

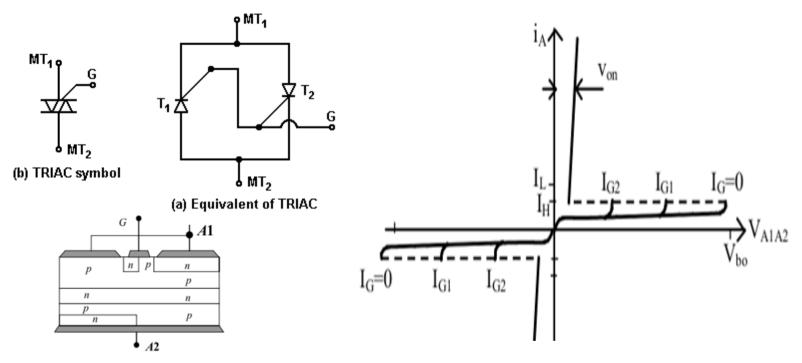
#### 3. Gate Turn-Off thyristors (GTO):

- Puede apagarse mediante una señal negativa en el gate.
- Puede no bloquear la tensión inversa (fugas).
- Tiene varias ventajas sobre un SCR:
  - Requiere menos componentes circuitales.
  - Alta velocidad de apagado.
- Tiene varias ventajas sobre los transistores:
  - Mayor capacidad de bloqueo de tensión inversa.
  - Mejor capacidad de manejo de corrientes pico.
  - Menor corriente de activación (que el TBJ)
  - Una señal de activación mas corta



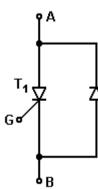


### 4. Triode of Alternating Current (TRIACs):



### 5. Reverse Conducting Thyristor (RCT)

- Tiene un diodo integrado en inversa
- Se usa en inverters DC-AC y choppers DC-DC.

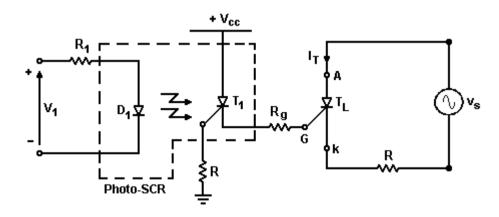


#### 6. Static Inductor Thyristor (SITH):

- Se apaga mediante un voltaje negativo en el gate.
- Tiene alta velocidad de conmutación y soporta grandes di/dt y dv/dt.

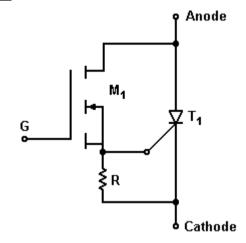
#### 7. Light Activated Silicon Controlled Thyristor (LASCRs)

- Se usa en aplicaciones de alto voltaje y corriente (líneas de HVDC)
- Brinda completa aislación entre el gate y la salida.
- El LASCRs no se puede apagar desde el Gate.



### 8. FET Controlled Thyristor (FET-CTHs)

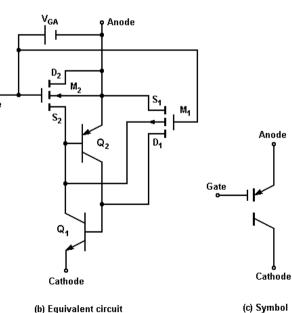
- Consiste de un FET en paralelo con un tiristor.
- No se puede apagar desde el Gate.



### 9. MOS Controlled Thyristor (MCTs):

Combinan características de SCR y de MOS: Gate

- 1. Baja caída de tensión ánodo-cátodo.
- 2. Rápido encendido y apagado.
- 3. Bajo consumo para switcheo
- 4. Baja capacidad de bloqueo de Vak inverso
- 5. Alta impedancia de gate.

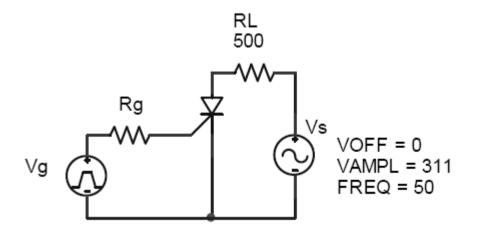


Se usa en apliaciones de baja velocidad.

### **Ejercicio**

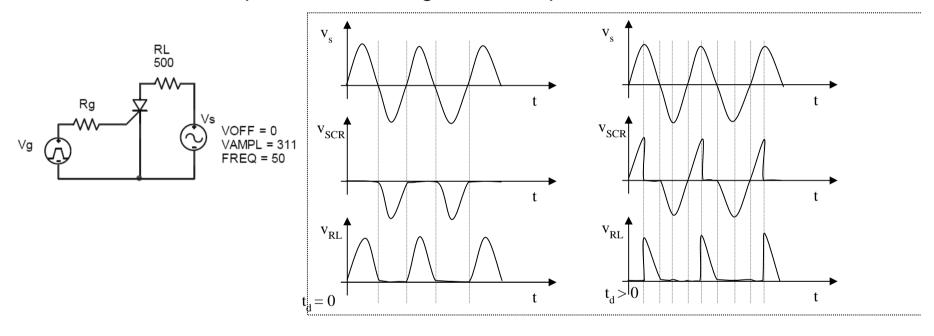
Un SCR se utiliza en el circuito de la figura,

- a) Dibujar las formas de onda de tensión en el SCR y en la RL para diferentes ángulos de disparo del dispositivo. Indicar cuando la potencia disipada en la carga es máxima.
- b) La caída de tensión en el SCR cuando conduce es aproximadamente 1 Volt. Las resistencias térmicas del SCR son Rjc = 1.5 °C/W y Rca = 62 °C/W. Las temperaturas máximas son Ta = 50 °C y Tj = 150 °C. Para el caso de máxima potencia disipada en la carga, determinar si el SCR necesita montarse sobre un disipador.



### Ejercicio (resolución)

Vemos la situación para distintos ángulos de disparos:



La potencia disipada en la carga es máxima cuando el disparo se produce en  $t_d$  = 0. Entonces, el SCR conduce durante un semiciclo completo de la señal, ya que en el semiciclo negativo el SCR se apaga.

### **Ejercicio**

Un SCR se utiliza en el circuito de la figura,

b) La caída de tensión en el SCR cuando conduce es aproximadamente 1 Volt. Las resistencias térmicas del SCR son Rjc = 1.5 °C/W y Rca = 62 °C/W. Las temperaturas máximas son Ta = 50 °C y Tj = 150 °C. Para el caso de máxima potencia disipada en la carga, determinar si el SCR necesita montarse sobre un disipador.

En el semiciclo en el cual no circula corriente (el SCR no conduce), el SCR no disipa potencia. En el semiciclo en el cual circula corriente, la caída en el SCR es de 1 Volt, aproximadamente en forma continua. Durante ese intervalo de tiempo la corriente pico que circula es:  $\hat{I} = \frac{311V - 1V}{500\Omega} = 0.62A$ 

Luego, se tiene entonces que la  $I_{ef}$  que circula por el SCR es:  $I_{ef} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0.62A}{\sqrt{2}} = 0.22A$ 

Por otro lado, la tensión eficaz en el SCR es:  $V_{ef} = \frac{1V}{2} = 0.5V$ 

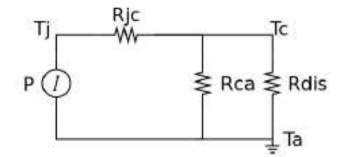
Entonces la potencia disipada del SCR durante el ciclo completo es:

$$P_{SCR} = 0.5V \cdot 0.22A = 0.11W$$

¿Se necesita disipador?

### **Ejercicio**

El modelo equivalente térmico del SCR es el siguiente:



Sin disipador tenemos:

$$P_{MAX} = \frac{Tj - Ta}{Rja} = \frac{150^{\circ} C - 50^{\circ} C}{63.5^{\circ} C/W} = 1.57W$$

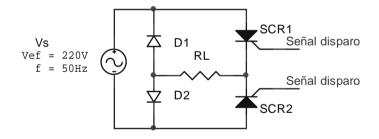
Así resulta:  $P_{MAX} > P_{disipada} = 0.11 W \rightarrow No se necesita disipador.$ 

Verificación:  $Tj = Ta + P \cdot Rja = 50^{\circ} C + 0.31W \cdot 62^{\circ} C / W = 69^{\circ} C < Tj_{MAX}$ 

### **Ejercicio**

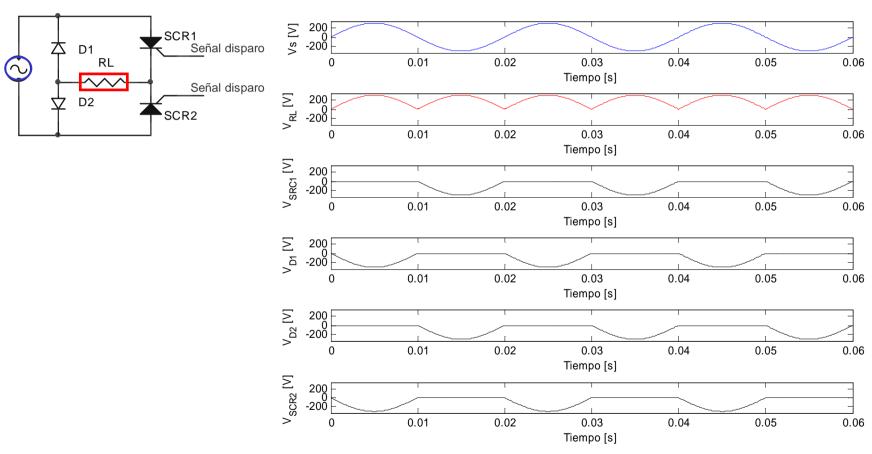
Dado el circuito de la figura, graficar la forma de onda en cada uno de los dispositivos y en la carga RL en las siguientes condiciones:

- a. Cada uno de los SCR conduce durante ½ ciclo de la señal Vs.
- b. Cada uno de los SCR conduce durante ¼ ciclo de la señal Vs.
- c. Los SCR no conducen en ningún momento.



### Ejercicio (resolución)

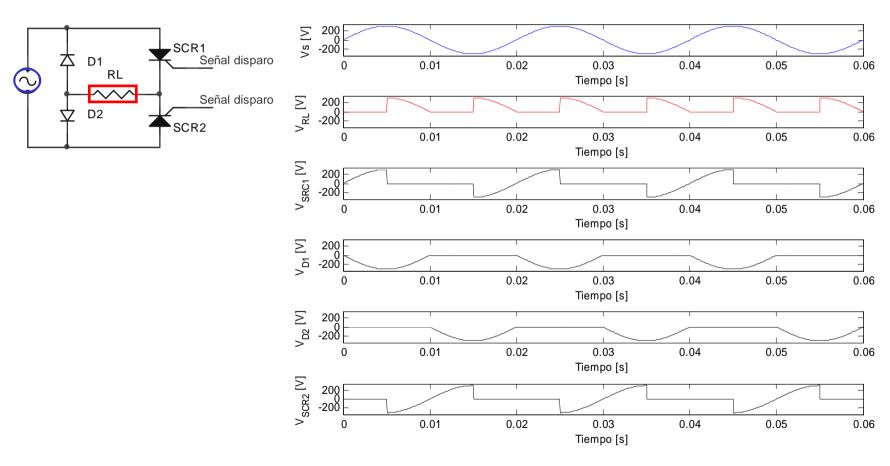
a. Cada uno de los SCR conduce durante ½ ciclo de la señal Vs.



¿Y qué pasa si los SCR conducen durante ¼ ciclo de la señal Vs?

### Ejercicio (resolución)

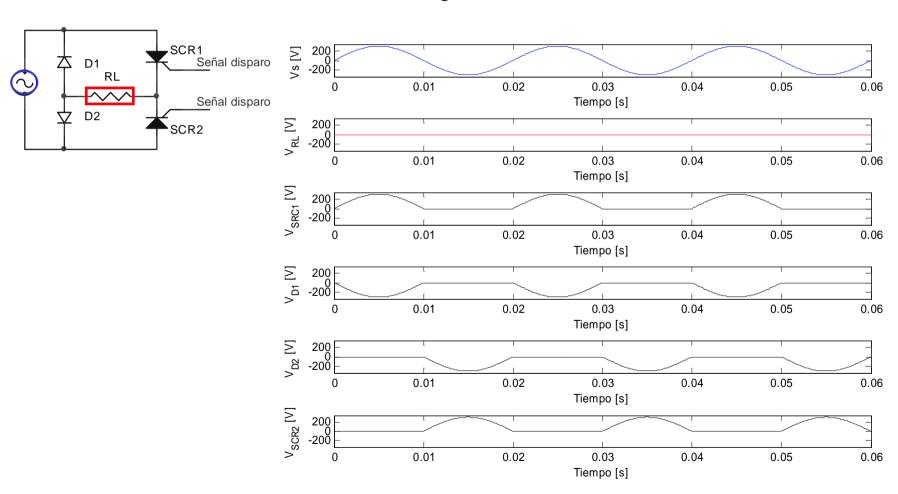
b. Cada uno de los SCR conduce durante ¼ ciclo de la señal Vs.



¿Y qué pasa si los SCR no conducen en ningún momento?

### Ejercicio (resolución)

c. Los SCR no conducen en ningún momento.



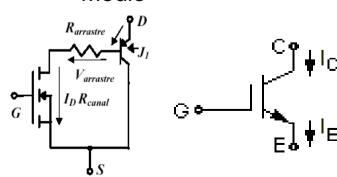
#### Características

Son transistores que deben soportar grandes corrientes, tensiones y potencias.

Parámetros	MOS	Bipolar
Impedancia de entrada	Alta (10 <sup>10</sup> $\Omega$ )	Media (10 $^4$ $\Omega$ )
Ganancia en corriente	Alta (10 <sup>7</sup> )	Media (10 a 100)
Resistencia ON (saturación)	Media / alta	Baja
Resistencia OFF (corte)	Alta	Alta
Voltaje CE/DS máx. aplicable	Alto (1000 V)	Alto (1200 V)
Máxima temperatura	Alta (200°C)	Media (150°C)
Frecuencia de trabajo	Alta (100-500 Khz)	Baja (10-80 Khz)
Costo	Alto	Medio
		- n

El IGBT ofrece entrada MOS y corriente de TBJ:

- Se activa por tensión (no por corriente).
- Tiempos de conmutación bajos.
- Soporta mayor disipación (como los bipolares).



#### -Características

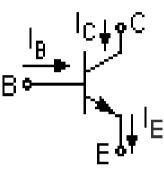
Nos interesa que el transistor se parezca a un elemento ideal:

- Manejo de alta potencia.
- Bajo tiempos  $t_{on} \leftrightarrow t_{off}$ .
- Alta densidad de corriente.
- Que apagado soporte alta tensión V<sub>CE</sub> o V<sub>DS</sub>.
- Que soporte grandes di/dt y dv/dt.

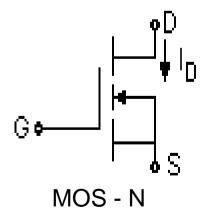
### Principios básicos de funcionamiento

- En un TBJ se controla  $I_C$  con  $I_B$ :  $I_C = \beta \cdot I_B$
- En un MOS se controla  $I_D$  con  $V_{GS}$ :  $I_D = k \cdot (V_{GS} V_T)^2$

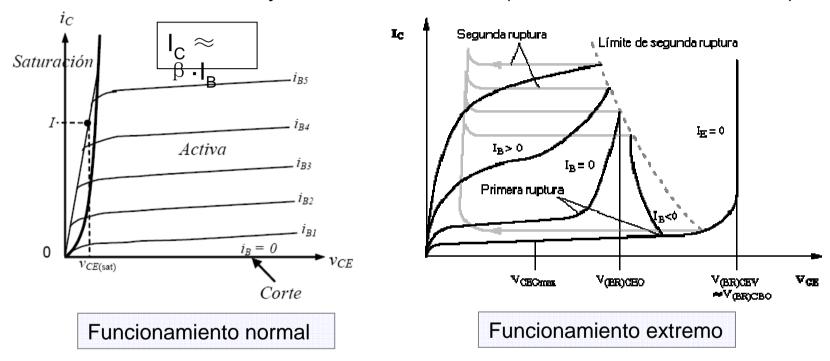
En ambos casos, con una potencia pequeña ( $I_B$  o  $V_{GS}$ ) se controla una mucho mayor ( $I_C$  o  $I_D$ ).



TBJ - NPN



Curvas de transferencia y avalanchas del TBJ (las del MOS son similares):



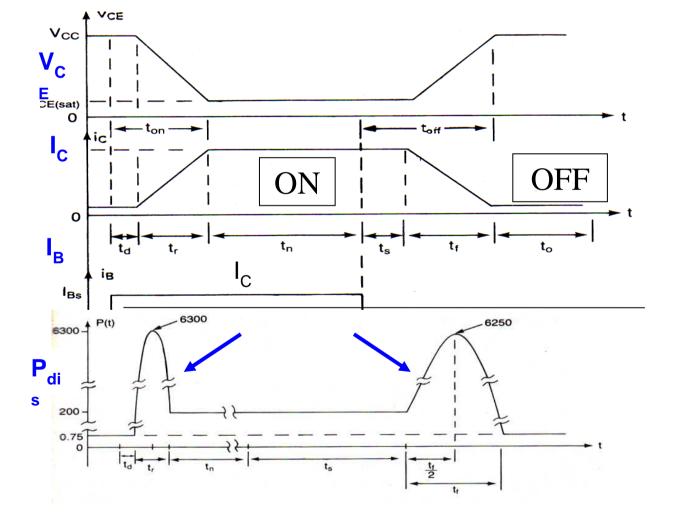
- Avalancha primaria: Superada la máxima  $V_{CB}$  con emisor abierto ( $V_{CBO}$ ), o la máxima  $V_{CE}$  con base abierta ( $V_{CEO}$ ), la unión C-B polarizada en inversa entra en un proceso de ruptura similar al de un diodo y conduce corriente.
- Avalancha secundaria: Puede darse una avalancha con tensiones por debajo de los límites anteriores debido a la aparición de puntos calientes (focalización de la intensidad de base). Está avalancha es destructiva. Debe evitarse.

#### Tiempo de conmutación y disipación

- Con el transistor en saturación o en corte las pérdidas son despreciables.
- Durante la conmutación se produce un pico de potencia disipada:

Esto es así porque:

$$Pot_{dis} = V_{CE} \cdot I_{C}$$
  
 $Pot_{dis-ON} = 0V \cdot I_{C}$ 



Ejemplos de dispositivos dañados:

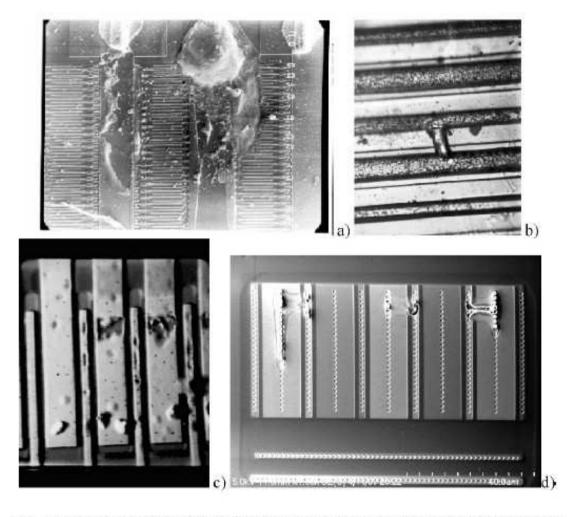
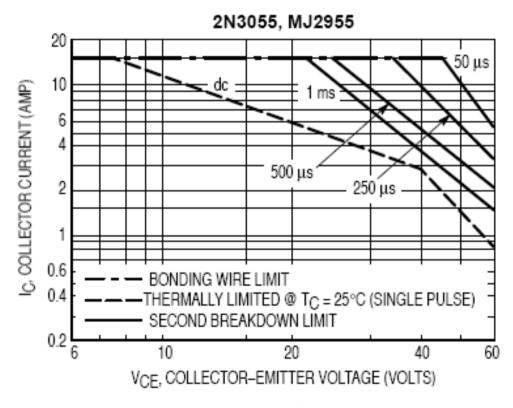


Fig. 1.1 Microphotographs of failed structures: Silicon bipolar transistor (a), SiMOSFET (b), GaAs MESFET (c), snapback NMOS at ESD pulse (d)

Zona de operación segura (SOA – Safety Operation Area):

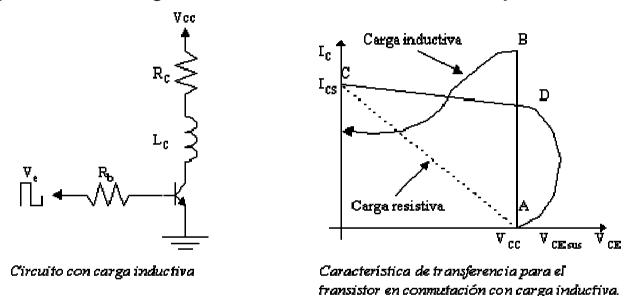
- La zona de funcionamiento está limitada por la disipación de energía:



- El transistor puede estar en la zona límite de la avalancha secundaria durante cortos intervalos de tiempo sin que se destruya.
- Para corrientes grandes se funden las conexiones metálicas

#### Efecto asociado a cargas inductivas:

- Las cargas inductivas generan las condiciones de trabajo más desfavorables:



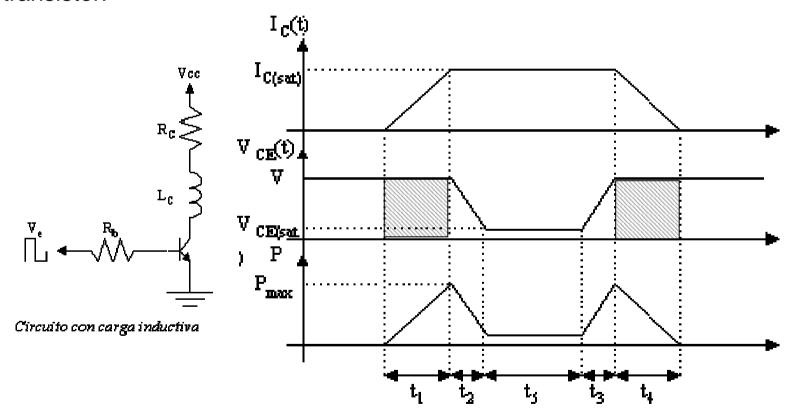
Para carga resistiva el transistor pasa de corte a saturación por la recta A-C-A

Para carga inductiva el transistor pasa a saturación recorriendo A-B-C-D-A:

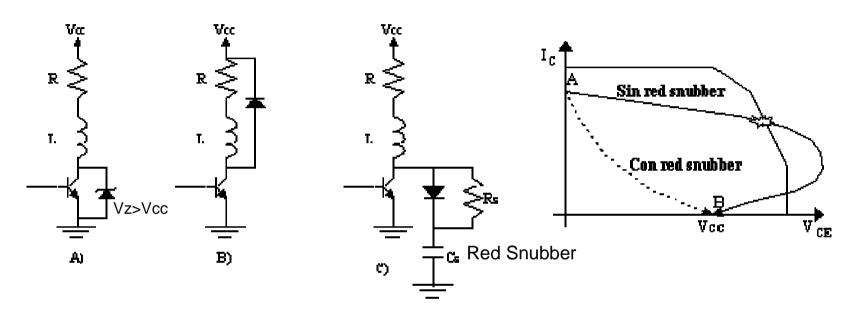
- Hay una profunda incursión en avalancha secundaria, con valor  $V_{\rm CE} >> V_{\rm CC}$ 

### Efecto asociado a cargas inductivas:

- Para cargas inductivas también hay un aumento en la disipación de potencia del transistor:



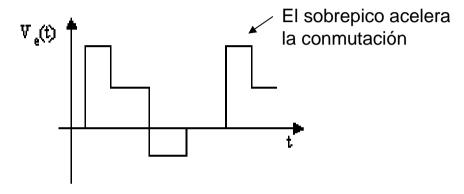
Circuitos de protección para cargas inductivas:



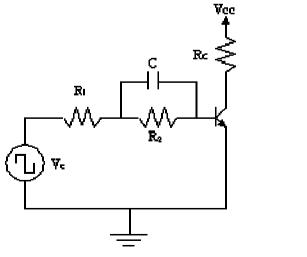
- En A) y B) se limita la VCE durante el paso de saturación a corte, proporcionando un camino para la circulación de corriente del inductor.
- En C) al cortarse el transistor la corriente pasa por el diodo y por Cs, el cual tiende a cargarse a Vcc. En saturación Cs se descarga a través de Rs.

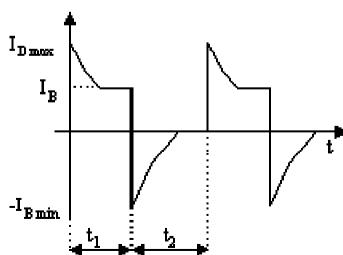
Circuitos de encendido del transistor:

El tiempo de conmutación puede reducirse usando una señal adecuada:



- Para esto puede emplearse el siguiente circuito:

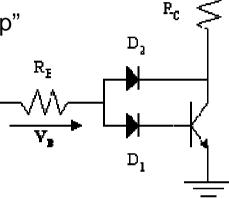




Circuitos de encendido del transistor:

Otra opción es el popular circuito anti-saturación:

"Enclavador Baker" = "Baker Clamp"



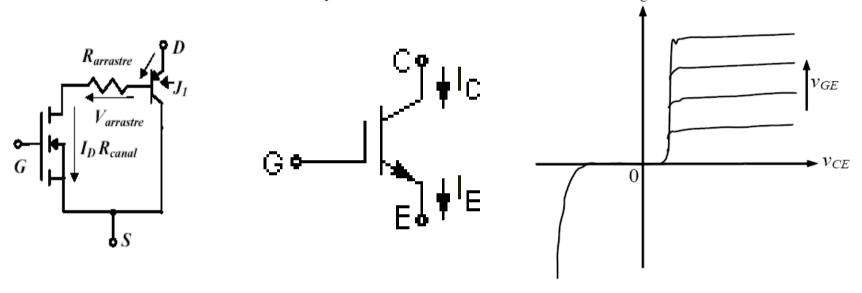
Vec

- El objetivo es evitar que durante la conducción la juntura B-C esté en directa (V<sub>B</sub> > V<sub>C</sub>) para así lograr minimizar el tiempo de apagado del transistor.
- Cuando la tensión de control aumenta, D<sub>1</sub> conduce una corriente I<sub>B</sub> que enciende el transistor. Entonces D<sub>2</sub> está en inversa (no conduce).
- Si la tensión de control sigue aumentando, entonces V<sub>C</sub> disminuye hasta que.
   D<sub>2</sub> está en directa y conduce. Entonces D<sub>1</sub> pierde corriente, el transistor
   "conduce menos" y V<sub>C</sub> aumenta, por lo que D<sub>2</sub> deja de conducir.

Este circuito usa una realimentación negativa para impedir que  $V_{\mathbb{C}}$  sea muy baja y así logra aumentar la velocidad de apagado del transistor.

**Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT):** 

Es una mezcla entre MOSFET y TBJ:



- El IGBT presenta alta impedancia de entrada como los MOSFET, y bajas perdidas de conducción como el TBJ, pero sin ruptura secundaria como el TBJ.
- El IGBT es mas rápido que el TBJ, pero mas lento que el MOSFET

#### Comparación de distintos tipos de transistores

BJT	MOSFET	IGBT	
1000-1200V	500-1000V	1600-2000V	
700-1000A	20-100A	400-500A	
25kHz	Hasta 300-400kHz	Hasta 75kHz	
P medias	P bajas, <10kW	P medias - altas	

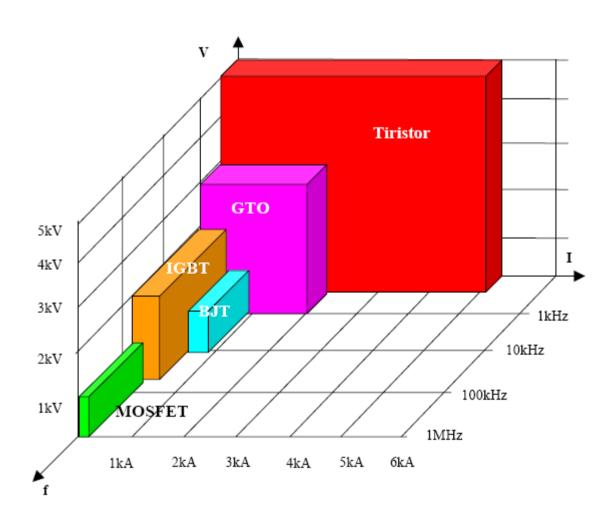
- Los valores no son exactos dada la gran disparidad del mercado.
- En general el producto tensión-corriente es una constante (limitación de potencia): hay MOSFET de muy alta tensión pero con corriente reducida.
- -Lo mismo ocurre con las frecuencias de trabajo: existen bipolares de poca potencia que trabajan a 50kHz, aunque no es lo usual.

### Prestaciones generales:

DISPOSITIVO	TENSIÓN	CORRIENTE	FRECUENCIA
DIODOS	<10kV	<5000A	<10MHz
TIRISTORES	<6000V	<5000A	<500Hz
GTOs	<6000V	<3000A	<500Hz
TRIACs	<1000V	<25A	<500Hz
MOSFETs	<1000V	<100A	<1MHz
BJTs	<1200V	<700A	<25kHz
IGBTs	<2000V	<500A	<75kHz

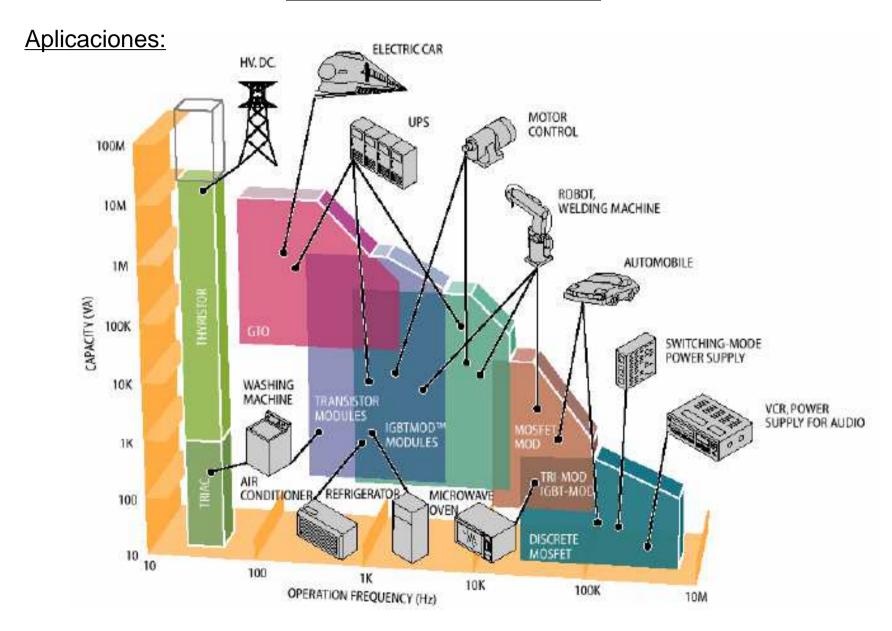
DISPOSITIVO	POTENCIA	FRECUENCIA
TIRISTORES	Alta	Baja
GTOs	Alta	Baja
TRIACs	Baja	Baja
MOSFETs	Baja	Alta
BJTs	Media	Media
IGBTs	Media-Alta	Media

### Prestaciones generales:



### Prestaciones generales:

	Dispositivos					
	DIODO	SCR	GTO	BJT	MOSFET	IGBT
Características de disparo		En corriente	En corriente	En corriente	En tensión	En tensión
Potencia del circuito de mando		Media - Alta	Alta	Media - Alta	Muy baja	Muy Baja
Complejidad del circuito de mando		Baja	Alta	Alta	Muy Baja	Muy Baja
D :111	36 31 / 63	A 1:	3.6.1: 41:	37.1	A1: TO :	4.1:
Densidad de corriente	Media p/ Alta	Alta	Media - Alta	Media	Alta - Baja	Alta
Máxima tensión inversa	Media	Alta	Alta	Baja - Media	Media - Baja	Madia - Alta
Perdidas en conmutación (circuitos convencionales)	Baja p/ media	Alta	Alta	Media - Alta	Muy Baja	Madia - Alta



# <u>Bibliografía</u>

- http://materias.fi.uba.ar/6625
- http://www.redeya.com
- <a href="http://www.eng.uwi.tt/depts/elec/staff/rdefour/courses/index33d.html">http://www.eng.uwi.tt/depts/elec/staff/rdefour/courses/index33d.html</a>
- "Power Electronics: Converters, Applications and Design", Mohan, Undeland y Robbins, John Wiley & Sons, 2<sup>a</sup> Ed, Nueva York, 1995.
- "Eletrónica de Potência", J. A. Pomilio, Universidade Estadual de Campinas, SP Brasil.
- "Electrónica de Potencia", D. W. Hart, Valparaíso University, Valparaíso Indiana. Prentice Hall.